

2021-2026年中国IC先进封装行业全景评估及投资 规划建议报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国IC先进封装行业全景评估及投资规划建议报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/electric/663294.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 IC封装产业相关概述

第一节 IC封装涵盖

第二节 IC封装类型阐述

第二章 2016-2020年世界IC封装产业运行态势分析

第一节 2020年世界IC封装业运行环境浅析

一、全球经济大环境及影响分析

二、全球集成电路产业运行总况

第二节 2020年世界IC封装运行现状综述分析

一、IC封装产业热点聚焦

二、IC封装业新技术应用情况

三、全球IC封装基板市场分析

四、全球IC封装材料市场发展

五、全球IC封装生产企业向中国转移

第三节 2016-2020年世界IC封装重点企业运行分析

一、英特尔（Intel）

二、IBM

三、超微

四、英飞凌（Infineon）

第四节 2021-2026年世界IC封装业趋势探析

第三章 2020年中国IC封装行业市场运行环境解析

第一节 中国宏观经济环境分析

第二节 中国IC封装市场政策环境分析

第三节 中国IC封装市场技术环境分析

一、高端IC封装技术

二、中高端IC封装技术有所突破

三、IC封装基板技术分析

第四章 中国IC封装产业整体运行新形势透析

第一节 中国IC封装产业动态聚焦

第二节 中国IC封装产业现状综述

第三节 中国IC封装产业差距分析

一、工艺技术

二、质量管理

三、成本控制

第四节 中国IC封装产思考

第五章 中国IC封装技术研究

第一节 中国IC封装技术热点聚焦

第二节 高端IC封装技术

一、IC制造技术

二、TAB Potting System

三、BGA,CSP Ball Mounting System

四、Flip-Chip Bonding System

五、TAB Marking System

六、TFT-LCD Cell Bonding System

第六章 中国高端IC-3D封装市场探析（3D-IC封装）

第一节 3D集成系统分析

第二节 中国高端IC-3D封装发展总况

第三节 高端IC-3D封装研究进展

第四节 3D-IC集成封装系统(SiP)的可行性研究

第七章 中国IC封装测试领域深度剖析

第一节 中国IC封装测试业运行总况

第二节 新型封装测试技术

一、MCM(MCP)技术

二、SiP封装测试技术

三、MEMS技术

四、BCC封装技术

五、Flash Memory(TSOP)塑封技术

六、多种无铅化塑封技术

七、汽车电子电路封装测试技术

八、Strip Test(条式/框架测试)技术

九、铜线键合技术

第八章 2016-2020年中国IC封装产业监测数据分析

第一节 2016-2020年行业偿债能力分析

第二节 2016-2020年行业盈利能力分析

第三节 2016-2020年行业发展能力分析

第四节 2016-2020年行业企业数量及变化趋势

第九章 2016-2020年中国IC封装产业运行新形势透析

第一节 中国IC封装产业运行综述

第二节 中国IC封装产业变局分析

第三节 中国IC封装业面临的挑战分析

第五节 对发展我国IC封装业的思考

第十章 中国IC封装细分市场运行分析

第一节 手机IC封装市场

第二节 手机基频封装

一、手机基频产业

二、手机基频封装

第三节 智能手机处理器产业与封装

第四节 手机射频IC

第五节 PC领域先进封装

第十一章 中国封装用材料运行分析

第一节 金线

第二节 IC载板

第十二章 中国分立器件的封装发展透析

第一节 半导体产业中有两大分支

第二节 分立器件的封装及其主流类型

一、微小尺寸封装

二、复合化封装

三、焊球阵列封装

四、直接FET封装

五、IGBT封装

六、无铅封装

七、几种封装性能同比

第三节 中国分立器件的封装现状综述

第十三章 中国IC封装产业竞争新格局探析

第一节 中国IC封装竞争总况

第二节 中国IC封装产业集中度分析

一、市场集中度分析

二、生产企业集中度分析

第三节 2021-2026年中国IC封装竞争趋势分析

第十四章 2016-2020年中国半导体（集成电路）封装重点企业分析

第一节 长电科技

- 一、企业介绍
- 二、企业经营业绩分析
- 三、企业市场份额
- 四、企业未来发展策略

第二节 深圳赛意法微电子有限公司

- 一、企业介绍
- 二、企业经营业绩分析
- 三、企业市场份额
- 四、企业未来发展策略

第三节 南通富士通微电子股份有限公司

- 一、企业介绍
- 二、企业经营业绩分析
- 三、企业市场份额
- 四、企业未来发展策略

第四节 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司

- 一、企业介绍
- 二、企业经营业绩分析
- 三、企业市场份额
- 四、企业未来发展策略

第五节 英特尔产品(成都)有限公司

- 一、企业介绍
- 二、企业经营业绩分析
- 三、企业市场份额
- 四、企业未来发展策略

第十五章 2016-2020年中国芯片封装重点企业分析

第一节 安靠封装测试(上海)有限公司

- 一、企业介绍
- 二、企业经营业绩分析
- 三、企业市场份额
- 四、企业未来发展策略

第二节 沛顿科技(深圳)有限公司

- 一、企业介绍
- 二、企业经营业绩分析

三、企业市场份额

四、企业未来发展策略

第三节 淄博凯胜电子技术有限公司

一、企业介绍

二、企业经营业绩分析

三、企业市场份额

四、企业未来发展策略

第四节 河南鼎润科技实业有限公司

一、企业介绍

二、企业经营业绩分析

三、企业市场份额

四、企业未来发展策略

第五节 盟事达智能卡技术(深圳)有限公司

一、企业介绍

二、企业经营业绩分析

三、企业市场份额

四、企业未来发展策略

第十六章 2016-2020年中国封装材料重点企业分析

第一节 汉高华威电子有限公司

一、企业介绍

二、企业经营业绩分析

三、企业市场份额

四、企业未来发展策略

第二节 厦门惠利泰化工有限公司

一、企业介绍

二、企业经营业绩分析

三、企业市场份额

四、企业未来发展策略

第三节 福建易而美光电材料有限公司

一、企业介绍

二、企业经营业绩分析

三、企业市场份额

四、企业未来发展策略

第四节 无锡创达电子有限公司

一、企业介绍

二、企业经营业绩分析

三、企业市场份额

四、企业未来发展策略

第五节 鼎贞(厦门)系统集成有限公司

一、企业介绍

二、企业经营业绩分析

三、企业市场份额

四、企业未来发展策略

第十七章 2021-2026年中国IC封装业投资价值研究

第一节 中国IC封装产业投资周期分析

第二节 2021-2026年中国IC封装投资机会分析

一、IC封装区域投资潜力「AK LT」

二、IC封装产业链投资热点分析

三、与产业政策调整相关的投资机会分析

第三节 2021-2026年中国IC封装投资风险预警

一、宏观调控政策风险

二、市场竞争风险

三、技术风险

四、市场运营机制风险

五、外资加大中国市场投资影响分析

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/electric/663294.html>